

高速电路PCB设计与EMC技术分析



[高速电路PCB设计与EMC技术分析_下载链接1](#)

著者:田广银

出版者:电子工业

出版时间:2011-6

装帧:

isbn:9787121136870

高速电路具有的许多特点，给PCB设计带来了电磁兼容、信号完整性、

电源完整性等问题，本书基于常用的PCB设计软件的应用，详细介绍了组成该系统的各个技术模块的性能特点与连接技术。

田广锬、范如东等编著的《高速电路PCB设计与EMC技术分析(第2版)》

从高速电路的特点出发，分析高速电路与低速电路的区别，进而概括出高速电路所面临的三大问题：电磁兼容、信号完整性和电源完整性。并对这些问题的来龙去脉及其危害做了详细的分析；最后，通过具体的实例将这些问题的解决方法贯穿到高速电路PCB设计的全过程之中。

《高速电路PCB设计与EMC技术分析(第2版)》理论体系完整、内容翔实、语言通俗易懂，实例具有很强的针对性和实用性，既可作为电子信息类专业的本科或专科教材，也可供从事高速电路工程与应用工作的科技人员参考。

作者介绍:

目录: 上篇 基础篇 第1章 高速电路设计概述 1.1 高速信号 1.1.1 高速的界定 1.1.2 高速信号的频谱 1.1.3 集总与分布参数系统 1.2 无源器件的高频特性 1.2.1 金属导线和走线 1.2.2 电阻 1.2.3 电容 1.2.4 电感和磁珠 1.3 高速电路设计面临的问题 1.3.1 电磁兼容性 1.3.2 信号完整性 1.3.3 电源完整性 1.4 本章小结 第2章 电磁兼容基础 第3章 PCB上的电磁干扰 第4章 高速电路信号完整性 第5章 信号完整性测量 第6章 高速电路电源完整性 第7章 去耦和旁路 下篇 应用篇 第8章 高速电路PCB的布局和布线 第9章 现代高速PCB设计方法及EDA 第10章 PowerLogic & PowerPCB——高速电路设计 第11章 HyperLynx——信号完整性及EMC分析 第12章 实例——基于信号完整性分析的高速数据采集系统的设计附录A 常用导体材料的特性参数附录B 常用介质材料的特性参数附录C 变化表附录D 国际单位的前缀附录E 电磁兼容常用术语附录F 我国的电磁兼容标准参考文献
· · · · · (收起)

[高速电路PCB设计与EMC技术分析_下载链接1](#)

标签

电子

高速电路PCB设计与EMC技术分析

PCB

评论

[高速电路PCB设计与EMC技术分析_下载链接1](#)

书评

[高速电路PCB设计与EMC技术分析_下载链接1](#)